

便簽 日期：
單位：研究發展處

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

學術發展組擬辦：

- 一、文陳閱後，公告於學校首頁最新消息及本處訊息公告。
- 二、文存。

會辦單位：

第二層決行		
承辦單位	會辦單位	決行
<p>行政處 盧錦惠 辦事員</p> <p>113. 3. 18</p> <p>副教授兼 林淑萍 組長</p> <p>教授兼 宋振銘(甲) 研究發展處長</p>		<p>代為決行</p> <p>教授兼 宋振銘(甲) 研究發展處長</p>

裝

訂

線



中華民國台灣半導體產業協會 函

機關地址:新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 53 館 802 室

聯絡人及電話: 石英堂協理, 03-5917092

受文者: 國立中興大學

速別: 最速件

密等及解密條件: 無

發文日期: 中華民國 113 年 3 月 15 日

發文字號: (113) 導協字第 014 號

附件: 2024 TSIA 半導體獎得獎名單

主旨: 檢送本會「2024 TSIA 半導體獎: 具博士學位之新進研究人員」與「2024 TSIA 半導體獎: 博士研究生」得獎名單, 請惠予公告。

說明:

- 一、感謝 貴校推薦優秀學生參加本會所舉辦之「2024 TSIA 半導體獎: 具博士學位之新進研究人員」與「2024 TSIA 半導體獎: 博士研究生」甄選活動, 本活動已由本會遴選委員會全體委員, 秉著公平嚴謹的原則, 順利完成所有的評審作業, 得獎名單(如附件)。
- 二、本得獎名單已於 2024 年 3 月 15 日公告於本會官網 www.tsia.org.tw, 並通知得獎者。
- 三、本會將於 2024 年 10 月 (暫定) 2024 TSIA 年會公開表揚與頒獎, 同時發佈新聞稿, 供社會大眾知悉。
- 四、甄選必有遺珠之憾, TSIA 半導體獎遴選委員會衷心希望 貴校繼續鼓勵優秀學生參加甄選, 為台灣半導體產業之發展而戮力前進。

正本: 國立臺灣大學、國立清華大學、國立陽明交通大學、國立成功大學、國立中興大學、國立中央大學、國立中正大學、國立中山大學

副本: TSIA 半導體獎遴選委員會、TSIA 產學委員會

總收文

113.3.18

國立中興大學



1130051392

符合本校「文書處理要點」第18條、33條規定, 以紙本公文辦理。

研究發展處
113.3.18
收件專用章

理事長 侯永清



2024 TSIA半導體獎得獎人名單

評選出具博士學位之新進研究人員11名博士研究生從缺

申請獎項	編號	姓名	學校	系所	推薦者
博士研究生	1	向國瑜	國立陽明交通大學	電子研究所	侯拓宏
	2	余心仁	國立成功大學	微電子工程研究所	王永和
	3	吳秉駿	國立清華大學	電子工程研究所	張孟凡
	4	周冠儒	國立中山大學	物理所	張鼎張
	5	涂玉發	國立清華大學	電子工程研究所	連振忻
	6	洪明峻	國立陽明交通大學	電子研究所	侯拓宏
	7	張承洋	國立臺灣大學	電子工程學研究所	吳安宇
	8	陳彥龍	國立臺灣大學	電子所	楊家驥
	9	陳翠帆	國立陽明交通大學	應用化學系	陳俊太
	10	劉亦浚	國立臺灣大學	電子工程學研究所	劉致為
	11	蘇建維	國立清華大學	電機工程學系	張孟凡
具博士學位之新進研究人員	1	從缺			

(依姓氏 / 學校筆畫排列)
公告時間:2024.3.15